

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **PFBGA7U-144 / Halogen free**

JEITA Package name; **(P-TFBGA-144-0707-0.50)**

Solder ball Type; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.09 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	21.0	シリコン	7440-21-3	21.0	999914	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00004	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.00011	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0004	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.00011	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00004	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0004	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.0006	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00004	2	配線材
PKG	保護膜	0.42	ポリイミド	-	0.42	1000000	保護膜 ※4
			回路基板	-	2.90	175310	強化材
	回路基板	16.7	硫酸バリウム	7727-43-7	0.66	40790	添加剤
			エポキシ樹脂	-	3.30	197180	主剤
			アクリレート系樹脂	-	1.00	57800	主剤
			顔料	-	0.42	25520	添加剤
			有機フィラー	-	0.06	3400	充填剤
			亜鉛	7440-66-6	0.015	920	特性向上
			クロム	7440-47-3	0.0005	30	特性向上
			銅	7440-50-8	7.00	419050	銅箔(パターン配線)
			ニッケル	7440-02-0	1.10	64000	メッキ
			金	7440-57-5	0.27	16000	メッキ
	ダイアタッチ材	1.18	エポキシ樹脂	-	0.80	670000	接着剤
			アクリル樹脂	-	0.38	330000	接着剤
	半田ボール	10.02	錫	7440-31-5	9.60	957500	半田成分
			銀	7440-22-4	0.35	35000	半田成分
			銅	7440-50-8	0.07	7500	半田成分
	ボンディングワイヤー	0.36	金	7440-57-5	0.36	1000000	導体材
			モールド樹脂	-	2.00	50000	主成分
	モールド樹脂	40.28	エポキシ樹脂	-	2.00	50000	主成分
			シリカ	60676-86-0/-	35.20	873000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	0.08	2000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	2.00	50000	硬化剤
			有機リン化合物	-	0.20	5000	硬化促進剤
			その他	-	0.80	20000	添加剤

化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。

※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。